

博众精工科技股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度 评估报告

2026 年上半年，公司严格落实年度“提质增效重回报”行动方案战略部署，坚守“巩固优势、多元突破、协同整合”核心发展路径。报告期内，公司消费电子主业稳健夯实，新能源、半导体、汽车自动化等新兴业务持续放量，产业多元布局成效凸显，整体经营业绩实现稳步增长。2026 年半年度，公司实现营业收入 32.36 亿元，同比增长 72.44%；归属于上市公司股东的净利润 2.57 亿元，同比增长 58.18%。截至 2026 年 6 月末，公司在手订单金额 95.68 亿元，为全年业绩稳健增长筑牢基本盘、积蓄新动能。总体而言，公司上半年业务拓展、技术创新、治理升级、投资者回报等各项工作有序落地，“提质增效重回报”各项重点举措推进扎实、成效显著。

一、重点举措执行情况

（一）聚焦主业经营，多元增长格局持续夯实

1. 消费电子主业稳固，基本盘支撑有力

消费电子业务作为公司的核心营收基本盘，2026 年半年度实现营业收入 11.33 亿元，占总营收的 35.01%。报告期内，公司紧跟头部终端客户技术迭代节奏，深度参与下一代智能终端产品制程前置研发，顺利完成多款新品制程设备的开发、调试与客户验证工作，持续巩固在消费电子领域的核心竞争优势。

客户拓展方面，公司持续深化与 vivo、OPPO、荣耀等国内头部消费电子企业的战略合作，稳定获取批量订单；与三星等国际知名品牌的合作取得实质性突破，相关设备已完成打样并进入测试落地阶段，海外客户版图进一步扩大。

截至 2026 年半年度末，消费电子行业在手订单达 32.94 亿元，同比增长 140%，为下半年业绩释放奠定坚实基础。

产能与服务布局方面，为更好地满足华南核心客户属地化服务需求，公司于 2026 年 7 月新增深圳分公司作为“消费电子行业自动化设备升级项目”的实施主体，进一步缩

短交付周期、提升客户响应效率。同时，公司持续推进全球化产能与服务网络布局，越南、新加坡等海外子公司运营能力稳步提升，消费电子业务全球化服务体系日趋完善，长期增长基础持续夯实。

2. 新能源业务规模化落地，成长引擎势能强劲

新能源业务已成长为公司的核心增长引擎。2026 年半年度实现营收 17.05 亿元，占总营收的 52.68%。公司核心产品方腔注液机、圆柱电池注液机、转盘注液机市场认可度持续提升，锂电核心设备出货量大幅增长，行业市场份额稳步提升。

产能建设层面，公司新能源智能装备研发制造基地落地吴江经济技术开发区，项目于 2026 年 1 月 3 日正式奠基开工，总投资 10 亿元，规划用地 144 亩，总建筑面积 18.7 万平方米。项目建设高效推进，自奠基至完成关键节点仅用时 40 天，顺利实现“除夕前 3 天冲出正负零”的阶段性目标。项目全部建成达产后，将全面释放公司新能源业务产能优势，为后续业务高速增长提供坚实保障。

核心业务拓展层面，公司作为宁德时代换电站核心主力供应商，2025 年已完成 900 余座换电站交付，累计承接充换电站订单超 1000 座。结合宁德时代 2026 年全国布局规划，全年将在全国约 120 座城市落地超 2500 座巧克力换电站，为公司换电业务持续增长提供充足市场空间。报告期内，公司智能充换电站业务订单实现较快增长。

截至 2026 年半年度末，公司新能源行业在手订单 48.25 亿元，同比增长 99.71%，业务增长确定性较强。

3. 半导体业务突破性增长，打造全新核心增长极

当前全球算力产业高速迭代，AI 算力中心、通用大模型、高阶自动驾驶产业快速发展，推动高速光互联体系持续升级，光模块成为算力基础设施核心刚需器件。2026 年全球光模块行业进入 800G 规模化普及、1.6T 商用落地的关键周期，下游头部厂商持续扩产、海外建厂，带动上游光通信封装设备行业迎来高速发展窗口期。针对高速光模块制造过程中精度、一致性、效率三大核心痛点，公司搭建完善的智能制造体系，覆盖核心工艺装备、自动化制造单元、智能物流协同及整厂方案规划能力，实现从单一核心设备供应商向光通信封装自动化系统解决方案服务商的战略升级，半导体业务是公司 2026 年最具爆发力的增长板块。

2026 年半年度，公司半导体业务实现营收 2.22 亿元，同比增长 519.45%。核心产

品高精度共晶贴片机已获得行业全球领军企业 400G/800G/1.6T 批量订单。同时紧跟行业技术演进趋势，全面启动 3.2T、CPO 下一代核心设备研发，持续构筑技术领先优势。AOI 光学检测设备已完成全球头部封测厂送样，报告期内持续验证中。

截至 2026 年半年度末，公司半导体业务在手订单 6.76 亿元，业务增长确定性较强。

产业布局方面，公司 2026 年完成对国家级专精特新“小巨人”企业中南鸿思的收购，补齐光学耦合核心工艺短板。中南鸿思深耕光模块 FA 自动耦合机等核心设备研发制造十余年，拥有授权发明专利 13 项、软件著作权 20 余项，产品覆盖 400G 至 1.6T 全系列光模块耦合设备共计 30 余款，累计设备交付量超 2000 台/套，技术积淀深厚、客户资源优质。依托并购协同优势，公司成功构建“共晶贴片+光学耦合+自动化测试+智能装配”全工艺链路，具备单机设备、自动化产线、整厂解决方案全维度服务能力。2026 年 5 月，公司携手中南鸿思亮相第二十一届中国光谷国际光电子博览会，集中展示光模块自动化全链路解决方案，行业品牌影响力持续提升。

此外，公司 2025 年完成收购上海栢智半导体并纳入合并报表，进一步完善泛半导体产业布局。栢智科技深耕半导体特气、化学品输送系统领域，累计服务 230 余家行业标杆客户，覆盖芯联集成、北方华创、拓荆科技、中船特气、林德气体等国内泛半导体龙头企业，先后斩获“林德 Linde 集团东亚大区最佳项目成就奖”“中芯国际优秀供应商”等多项行业荣誉。2026 年以来，栢智科技持续中标重大项目，其中 3 月中标 1183 万元中船（邯郸）派瑞特种气体充装柜项目，5 月中标 990 万元吉林华微电子八寸线工艺设备二次配项目及特气、化学品供应工程，7 月再度中标 920 万元特气一次配、二次配施工项目，订单落地节奏持续加快。同时，公司携核心产品亮相 SEMICON CHINA 2026、无锡国际气体工业博览会等行业顶级展会，持续提升行业知名度，GasBox 气控设备、电子级化学品输送系统等新品已形成稳定增长曲线。

4. 全球化布局纵深推进，海内外双轮驱动格局成型

公司坚持“国内深耕、海外突破”双轮驱动战略，持续完善全球化产能布局与本地化服务网络，稳步提升海外市场渗透率与全球交付能力。

海外布局层面，公司已在新加坡、美国、越南、匈牙利等多国家设立分子公司，搭建起覆盖东南亚、北美、欧洲的全球化服务体系。2026 年 6 月，公司拟为三家境外子公司合计新增 5.5 亿元担保额度，持续加大海外业务资源倾斜，强化全球化战略落地支

撑。

客户拓展层面，各业务板块全球化均取得积极进展：消费电子领域，公司与三星等国际品牌合作取得实质性进展，部分设备完成打样并进入测试阶段；汽车自动化领域，上海沃典持续深耕奔驰、大众等头部整车厂产业链，海外订单占比稳步提升，市场覆盖欧洲、美洲、东南亚、中东、非洲等地区（详细见前文“深化并购整合”部分）；新能源业务领域，公司换电站、注液机等核心产品已批量供应宁德时代等客户。

项目交付层面，2025 年 11 月，公司首条北美新能源电池物流线成功出海，全面符合北美技术规范，实现全维度合规，顺利交付北美客户。同时，汽车自动化产线、智能物流设备等产品持续落地全球多区域市场，积累了成熟的海外项目交付、调试、运维经验，形成从方案定制、设备交付到本地化售后的全流程全球服务能力。

（二）深化并购整合赋能，产业协同效益持续释放

报告期内，公司持续强化上海沃典、上海栢智、中南鸿思三家并购子公司的投后管理、战略融合与资源协同，从战略对齐、技术互补、市场共享、产能协同多维度深化整合，并购价值持续兑现，新兴业务板块竞争力显著提升。

1.上海沃典：全面融入集团战略，合力拓展全球汽车自动化市场

上海沃典于 2025 年 6 月底正式纳入公司合并报表范围，是一家专业提供工业智能自动化全方位解决方案的系统集成商，专注于汽车及汽车零部件的生产智能输送系统、自动化检测与测试技术、智能物流单元、智能装配生产系统及智能工厂信息化系统，其核心业务“柔性智能输送系统”与“数字化工厂系统集成”是对公司现有能力的强力补充。

业务协同层面，公司通过上海沃典有效补足了自身在汽车焊装、涂装、总装及电池工厂等制造自动化领域的业务短板，快速切入汽车智能装备市场。与此同时，上海沃典在智能工厂信息化系统、智能物流单元等领域的技术积累，可与公司在 3C 领域的精密制造技术形成协同，将汽车行业的整厂自动化解决方案经验迁移至 3C 产品生产基地建设。通过技术协同、资源共享、品牌赋能等举措，汽车自动化已成为公司继消费电子、新能源之后的又一核心板块。

市场拓展层面，上海沃典已与奔驰、大众、沃尔沃、小米、吉利、路特斯、小鹏、理想、上汽、奇瑞等国内外知名汽车企业建立了稳固合作关系。上海沃典自 2023 年起逐步拓展海外高毛利板块业务，并将其作为长期重要发展战略。目前，上海沃典在手订

单中已包含较高比例的欧美市场项目，其中欧洲市场订单占据优势比例。在博众精工的战略赋能下，上海沃典海外市场覆盖范围进一步扩展至欧洲、美洲、东南亚、中东、非洲等多个地区，新签国际项目数量同比显著增长，海外收入占比稳步提升。

2. 上海栢智：产能跃升与市场拓展并举，助力半导体装备国产化

投后赋能方面，公司充分发挥平台优势，在品牌、资金、供应链、人才、全球化网络等维度为上海栢智全方位赋能。2026 年 1 月，上海栢智二期工厂在上海松江集成电路产业核心区正式投产，产能规模、制造水平、交付能力实现跨越式提升。新工厂为先进半导体装备专业制造基地，配置万级洁净厂房、精密焊接设备、高精度检测仪器及核心零部件验证平台，聚焦特气输送、化学品供应、特种充装等五大类核心产品研发生产。升级后核心设备年产能提升至 3000 台（套），产品交付周期缩短 40%，核心产品取得 SEMI 2、CE、GC2 等多项权威资质认证。

技术研发方面，栢智科技自主研发的 Gas Box 气控设备、LDS 液态源输送设备等核心产品，打破海外技术垄断，可适配 7nm 及以下先进制程生产需求。当前国内半导体特气输送系统核心设备国产化率不足 30%，进口替代空间广阔。公司依托栢智科技的技术积累与客户资源，持续推进核心设备研发量产落地，深度参与国内半导体高端装备国产化进程。

3. 中南鸿思：技术协同深度融合，打造光通信封装整线解决方案

公司 2026 年完成中南鸿思并购，快速补齐光通信精密耦合核心技术，完善光子产业全链条布局。中南鸿思成立于 2015 年，是一家国家级专精特新“小巨人”企业，创业团队核心成员来自中南大学高性能复杂制造国家重点实验室的硕博士团队。深耕光学耦合工艺十余年，技术壁垒深厚、研发实力强劲，服务国内外 60 余家企业及科研机构，产品远销韩国、越南、美国等海外市场。

整合落地后，双方实现了技术、人才与供应链的深度协同。公司半导体板块的精密贴装、整线集成能力，与中南鸿思光学耦合核心技术深度互补，成功构建起“共晶贴片+光学耦合+自动化测试+自动化装配”的完整工艺链路，真正实现从单机设备供应向系统级解决方案的升级。

市场协同层面，2026 年 5 月，博众半导体携手中南鸿思联合参展第二十一届中国光谷国际光电子博览会，集中展示光模块自动化全链路解决方案。核心设备包括高精

度共晶机、固晶机及 FA 自动耦合机等，贴片精度达 $\pm 1.5\mu\text{m}$ 。博众半导体与中南鸿思实现技术互补与产能协同，并依托全球化布局服务东南亚、北美、欧洲等市场。此外，中南鸿思第二交付中心已正式投产，依托博众精工在精密自动化领域的平台能力、标准化模块化生产体系及全球供应链网络，中南鸿思在交付周期、供应链成本、人才梯队、全球服务四大维度实现系统性跃升。

4. 并购整合综合成效

总体来看，公司通过上述一系列并购，在汽车自动化、半导体、光通信三大战略新兴领域实现了技术、渠道与资源的快速融通，形成了“3C+新能源+汽车+半导体”多轮驱动的业务格局。上海沃典、上海栎智、中南鸿思三家子公司均已纳入公司管理体系并全面融入集团战略，并购整合效益正逐步显现，为公司高质量发展注入了持续动能。

（三）技术创新驱动，核心技术攻坚取得新突破

1. 研发投入持续加大，创新底座不断夯实

2026 年半年度，公司持续加大研发资源投入，夯实技术领先优势。报告期内研发投入合计 3.22 亿元，较上年同期的 2.36 亿元增长 36.78%。研发投入占营业收入的比例为 9.96%。截至 2026 年半年度，公司拥有研发人员 2,262 人，充足的研发投入与人才储备为技术迭代、产品创新提供坚实支撑。

2. 知识产权布局完善，技术壁垒持续加固

2026 年上半年，公司持续强化知识产权护城河建设。截至 2026 年 6 月，公司本年度新增专利授权 113 项，累计拥有专利 3,652 项。公司围绕消费电子、新能源、半导体、光电子耦合封装等所有业务及前沿研发方向全面布局专利，形成了“研发—专利—应用—再研发”的良性循环。

3. 前沿技术有序布局，前瞻卡位行业趋势

公司立足 AI 智能制造、高端半导体、高速光通信等前沿领域，持续推进技术迭代与前瞻布局。在智能制造领域，持续优化消费电子、新能源自动化设备智能化水平，落地 AI 赋能生产场景；在半导体领域，重点攻坚固晶封装、AOI 视觉检测、半导体特气控制系统等核心技术；在光电子领域，依托中南鸿思深化高速光模块耦合封装技术研发，紧跟行业技术迭代趋势，全面启动 CPO 下一代核心设备研发，提前卡位未来产业机遇。

（四）规范运作与治理效能持续优化

1. 治理结构不断完善

2026年4月，公司发布首份《2025年可持续发展报告》，全面呈现公司在环境、社会和公司治理领域的绩效表现。公司秩鼎 ESG 评级由 2025 年的 A 上升至 2026 年的 AA，位居 GICS 三级机械制造 516 家公司第 25 名，治理水平获得外部权威认可。

2. 合规风控体系持续强化

公司持续完善内控体系，加强子公司及新业务领域的合规管控。针对海外业务、供应链、知识产权等领域开展风险排查与防控，保障公司运营的合规性与科学性。公司治理结构持续完善，独立董事制度有效运行，保障了中小投资者的合法权益。

（五）投资者回报稳步提升

公司始终坚持稳健分红、回馈股东的经营理念，持续完善投资者回报机制。2026年7月，公司顺利完成 2025 年年度权益分派实施工作，以扣除回购股份后的总股本 446,022,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.48 元（含税），累计派发现金红利 6,601.13 万元（含税）。稳定的现金分红政策，充分体现公司良好的盈利能力与负责任的上市公司主体担当。

（六）强化投资者沟通，精准传递公司价值

1. 丰富交流渠道，高效传递企业价值

2026年上半年，公司积极搭建多元化投资者沟通平台，常态化开展业绩说明会、路演交流活动。2026年5月，公司召开一季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事等核心管理层全员出席，直面市场关切；同月，公司参与“十五五·未来产业”智能制造行业集体业绩说明会，全面向资本市场展示公司战略布局、业务进展与成长逻辑，有效提升公司市场认知度与品牌影响力。

2. 优化信息披露，保障投资者知情权

公司严格遵守监管规则，持续提升信息披露规范性、及时性与透明度。同时依托上证 e 互动、投资者热线等渠道，高效回应投资者咨询与诉求，切实保障中小投资者合法权益。

（七）健全激励约束机制，凝聚核心发展合力

公司持续完善绩效激励与考核体系，将经营业绩、市值管理、净利润率及研发成果转化率等关键指标纳入综合考核，推动管理层、核心骨干与公司、股东利益保持高度一致。目前公司尚在有效期内的股权激励计划包括 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划及 2026 年限制性股票激励计划，报告期内公司推出了 2026 年限制性股票激励计划；结合历次激励计划迭代，公司持续优化激励对象范围，聚焦核心价值创造，激励资源进一步向业务、研发等一线骨干人员倾斜，强化中长期绑定效果。同时，公司持续健全内控与合规管理体系，针对控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”建立常态化合规培训与风险警示机制，严格防范内幕交易、关联交易风险等各类合规风险。

二、经营存在挑战及改进提升方向

2026 年上半年，公司整体经营稳健向好、新兴业务高速增长，但受行业特性、业务结构及新业务培育周期等因素影响，经营发展仍存在阶段性挑战，公司已针对性制定优化改进方案：

一是整体毛利率阶段性承压。2026 年半年度，公司综合毛利率为 29.16%，同比下降 3.48 个百分点。主要系公司处于战略转型关键期，新能源、半导体等新兴业务处于规模化拓展初期，叠加产品结构持续优化调整，导致整体毛利率出现阶段性波动。后续随着新兴业务产能充分释放、规模效应持续显现、高附加值产品占比提升，公司整体盈利水平有望稳步修复。

二是扣非盈利质量仍需优化。报告期内，公司实现扣非归母净利润 0.98 亿元，同比增长 27.92%，盈利质量仍有提升空间。公司将通过持续优化产品结构、提升高端装备及解决方案业务占比、严控生产运营成本、提升经营管理效率等举措，持续优化盈利结构，夯实盈利能力。

三是募投项目建设进度有待提速。截至 2026 年 6 月 30 日，公司“新建研发中心项目”投资进度为 15.15%，整体推进节奏偏缓。后续公司将强化项目专项管理，细化建设节点、压实责任、加快施工进度，保障募投项目按计划落地投产，充分发挥募投项目赋能研发创新、助力产业升级的核心作用。

三、下半年重点工作规划

2026 年下半年，公司将持续锚定“提质增效重回报”核心目标，坚守高质量发展主线，巩固主业优势、放大新兴动能、深化技术创新、优化经营质量，全力推动全年经营目标落地，重点推进以下工作：

1. 深耕消费电子主业，筑牢营收基本盘。持续紧跟头部终端客户技术迭代节奏，深度参与客户新产品的研发，稳固行业核心地位。

2. 加速新能源业务规模化，打造行业龙头优势，持续深化与宁德时代等核心客户的战略合作。

3. 推动半导体业务持续放量，兑现并购协同价值。持续深化中南鸿思、上海栢智的投后整合与业务协同，紧抓全球光模块扩产、半导体设备国产化双重机遇，加快共晶贴片机、光学耦合机、半导体特气设备等核心产品订单交付。充分发挥光通信全工艺链路优势，持续拓展海内外优质客户，推动半导体业务持续高速增长。

4. 加码核心技术研发，构筑长期创新壁垒。提速推进新建研发中心募投项目建设，完善研发创新体系。聚焦 CPO 前沿光通信技术，持续迭代下一代高端封装设备产品。围绕 AI 智能制造、半导体高端装备、光电子精密封装等前沿赛道加大专利布局力度，持续强化技术领先优势。

5. 深化全球化战略，拓展海外增长空间。持续完善海外本地化产能与服务网络，提升东南亚、欧洲、北美核心市场交付与运维能力。依托上海沃典全球化渠道，持续拓展海外汽车自动化市场，推动各业务板块海外业务协同突破，持续提升海外营收占比。

6. 优化投资者回报与市值管理。在保障公司中长期稳健发展的基础上，持续维持稳定、可持续的现金分红机制，积极回馈广大投资者。持续优化信息披露质量与投资者沟通机制，精准传递公司战略价值、技术优势与成长逻辑，提升资本市场认可度。

四、总结

2026 年上半年，公司在“提质增效重回报”行动方案的指引下，消费电子主业稳健增长，新能源业务快速规模化，半导体业务实现突破性发展，在手订单充裕，经营业绩实现显著增长。公司在技术创新、治理优化、投资者回报等方面均取得了积极进展，行动方案各项重点举措执行有力、成效显著。

下半年，公司将持续践行科技创新赋能产业发展的核心使命，深耕高端智能制造赛

道，持续深化“巩固优势、多元突破、协同整合”发展路径，全力攻克经营短板、放大产业优势、释放增长动能，力争实现全年营收与净利润稳健双增，持续提升公司核心竞争力与投资价值，切实履行上市公司社会责任，与全体投资者共享企业高质量发展成果。

博众精工科技股份有限公司

2026年8月25日